



## 一种用于芯片制造的刻蚀与沉积-剥离融合方法

**专利名称:** 一种用于芯片制造的刻蚀与沉积-剥离融合方法  
**专利类别:** 发明  
**申请号:** 2018116112503  
**第一发明人:** 李贺康  
**其它发明人:** 金贻荣;郑东宁  
**专利授权日期:** 2020-11-10

[关闭窗口](#)

